



Jeudi 7 octobre 2010

MICRO APPLICATIONS LASER ET SURFACES

Le laser présente de nombreux avantages pour travailler dans le domaine de l'usinage fin. Le micro usinage par laser est principalement utilisé pour la fabrication d'objets de très faibles dimensions où l'enjeu est généralement de réduire au maximum la zone affectée thermiquement tout en la contrôlant. Après une présentation des nouveaux lasers qui limitent l'impact thermique et facilitent ces traitements de précision, il y aura des exposés sur des applications traitant l'extrême surface comme le marquage, l'ablation de couches minces, le décapage, le grainage ou le micro-usinage par laser. En fin d'après-midi, une table ronde animée par un journaliste clôturera la journée.

PROGRAMME

Les réponses des nouveaux lasers face aux exigences du marché : ALFA VENTURE, Alain Biernaux
Ablation de surface sur silicium et métaux : ALPHANOV, John Lopez
Décapage fin : IREPA LASER, Frédérique Machi
Micro-structuration de surfaces, applications dans le photovoltaïque : ROFIN BAASEL, Thierry Vialard
Potentiel du laser picoseconde pour le micro usinage : LASAG, Noémie Dury
Micro usinage, évolution du procédé avec les nouveaux lasers : AGIE CHARMILLES, Dino Paganelli
Lithographie par laser : RBNANO, Loïc Mager
Applications industrielles des lasers à impulsions ultra-courtes : TRUMPF, Stéphanie Trousselle
Applications nouvelles des lasers à impulsions ultra courtes : OXFORD LASERS, Céline Bansal
Table ronde animée par le journaliste Didier Bonnet

RENSEIGNEMENTS UTILES

Horaires : 9h00 – 16h30

Lieu : IREPA LASER – 67400 Illkirch

Renseignements : Monique Caboche – 03 88 65 54 10 – mc@irepa.u-strasbg.fr